

SESUB (半導体内蔵基板)

Under development

SESUB (Semiconductor Embedded in Substrate)

SESUB技術で小型・高信頼の複合半導体パッケージを実現

ICペアチップを樹脂基板内に内蔵し、銅めっき接続で基板と接合する半導体内蔵樹脂基板。ICはウェハレベルで自社加工し内蔵する為、高い品質の製品をご提供します。TDKの豊富なモジュール設計経験と、多くの製品量産実績でお客様の開発をバックアップします。

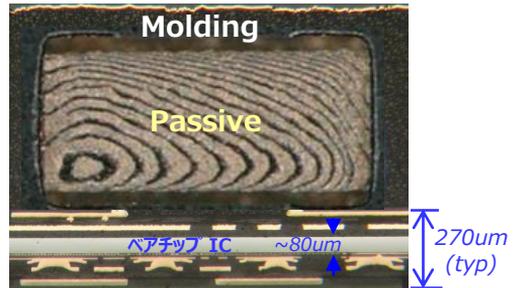
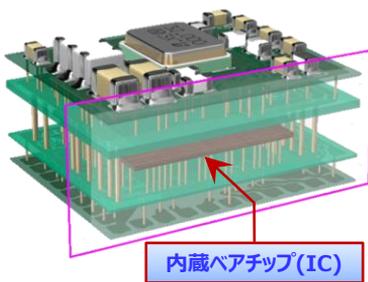
特長

- 複数のICを内蔵しても小型化が可能
- 優れた熱放散性
- 内蔵ICの高い長期接続信頼性

主要用途

- 車載用機器の局所回路のモジュール化
- ウェアラブルデバイス、スマートフォンアクセサリ
- 各種センサ用パッケージ

特性



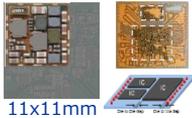
省スペースを実現する小型・高集積化

従来工法



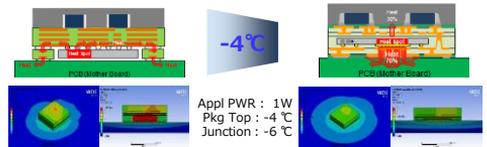
SESUB

※小型化一例



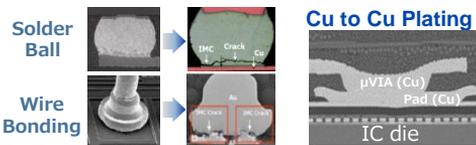
ICと周辺回路の統合、複数ICの高効率内蔵化

設計自由度を上げる熱放散性



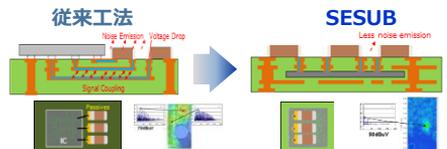
内蔵IC発熱部に放熱VIAを集中配置し放熱設計を容易に

長期接続信頼性を実現する銅めっき接続



はんだやワイヤボンド接続と比較して高信頼な接続信頼性

3次元パッケージ



3次元実装による配線寄生成分の低減で電気特性の改善